

2024年3月期  
**決算説明資料**

2024年5月20日  
**内外テック株式会社**  
(証券コード 3374)



2024年3月期  
**決算ハイライト**

## 本日のポイント

### POINT

# 1

#### 2024年3月期実績

半導体メーカーの在庫調整と設備投資延期により、減収減益

売上高 **39,013**百万円  
(前期比▲13.8%)

営業利益 **1,218**百万円  
(前期比▲48.1%)

親会社株主に帰属する当期純利益 **848**百万円  
(前期比▲48.2%)

### POINT

# 2

#### 2025年3月期予想 市況の回復を見込み増収増益

売上高 **43,800**百万円  
(前期比12.3%)

営業利益 **1,540**百万円  
(前期比26.4%)

親会社株主に帰属する当期純利益 **1,030**百万円  
(前期比21.4%)

### POINT

# 3

#### 配当方針変更

連結配当性向**30%以上**かつ連結株主資本配当率 (DOE) **3%以上**を目標とし、  
業績に応じた配当を継続していく



2024年3月期  
**連結業績・事業概況**

## 2024年3月期 業績 (2023年4月～2024年3月)

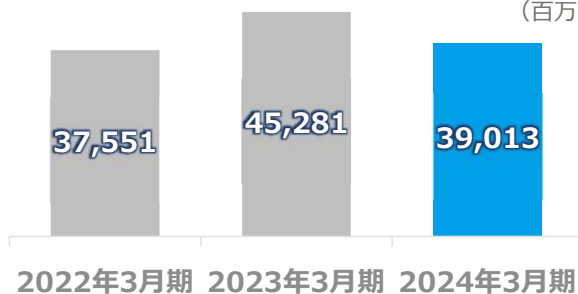
- ・半導体メーカーによる一時的な在庫調整や設備投資の先送りによる市況減速の影響を受け減収減益に

### 決算実績

(百万円)	2023年3月期			2024年3月期			2024年3月期
	実績	前期比	構成比	実績	前期比	構成比	予想 (5月12日公表)
売上高	45,281	20.6	100.0	<b>39,013</b>	<b>▲13.8%</b>	<b>100.0</b>	<b>40,100</b>
売上原価	40,121	21.4	88.6	<b>34,964</b>	<b>▲12.9%</b>	<b>89.6</b>	—
販管費	2,809	17.6	6.2	<b>2,830</b>	<b>0.7%</b>	<b>7.3</b>	—
営業利益	2,349	10.7	5.2	<b>1,218</b>	<b>▲48.1%</b>	<b>3.1</b>	<b>1,290</b>
経常利益	2,336	10.8	5.2	<b>1,189</b>	<b>▲49.1%</b>	<b>3.0</b>	<b>1,260</b>
親会社株主に帰属する 当期純利益	1,638	6.3	3.6	<b>848</b>	<b>▲48.2%</b>	<b>2.2</b>	<b>840</b>

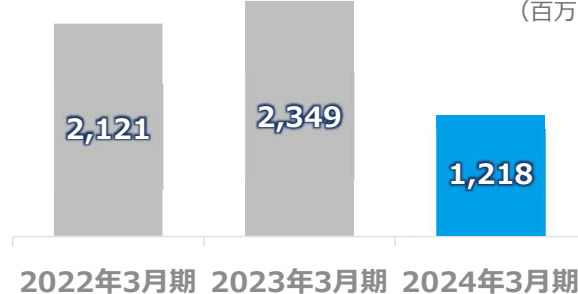
#### 売上高

(百万円)



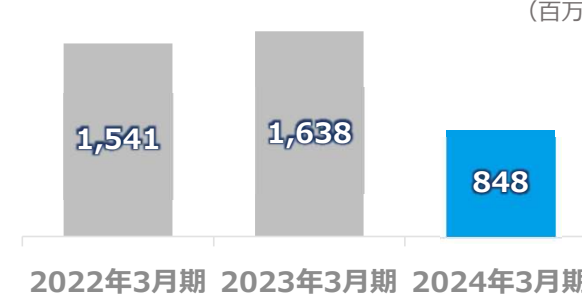
#### 営業利益

(百万円)



#### 親会社株主に帰属する当期純利益

(百万円)



# セグメント別 売上高/利益

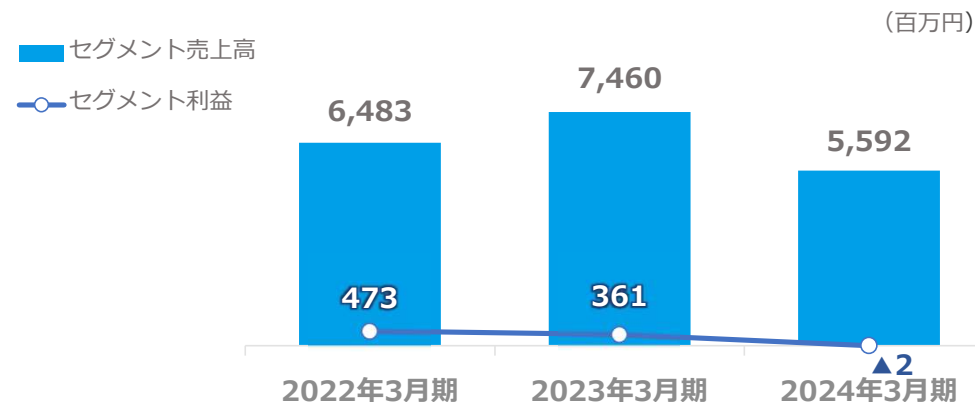
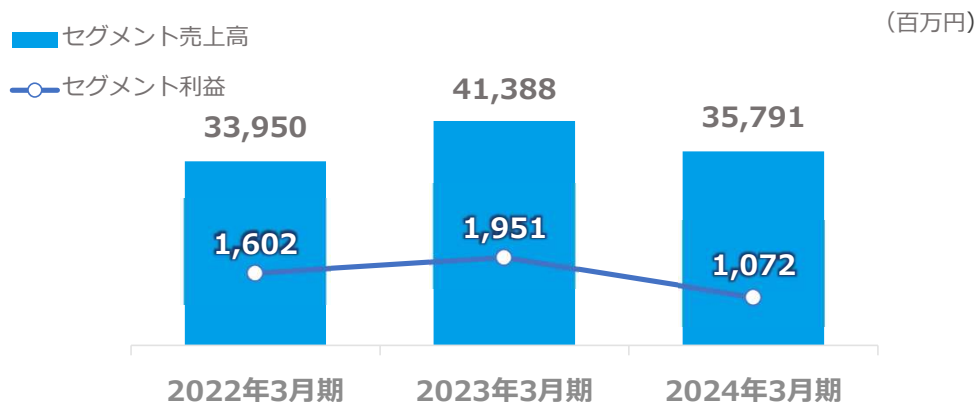
## ・ 販売事業、受託製造事業とも減収減益

### 販売事業

(百万円)	2023年3月期	2024年3月期	
	実績	実績	前期比
セグメント売上高	41,388	<b>35,791</b>	<b>▲13.5%</b>
セグメント利益	1,951	<b>1,072</b>	<b>▲45.0%</b>

### 受託製造事業

(百万円)	2023年3月期	2024年3月期	
	実績	実績	前期比
セグメント売上高	7,460	<b>5,592</b>	<b>▲25.0%</b>
セグメント利益	361	<b>▲2</b>	<b>—</b>



(注) セグメント売上高及びセグメント利益は、連結調整前の数値となっております

## セグメント別概況 販売事業

- 期初からの売上減少により利益も減少し、減収減益に

### セグメント売上高

**35,791**百万円 (前期比▲13.5%)

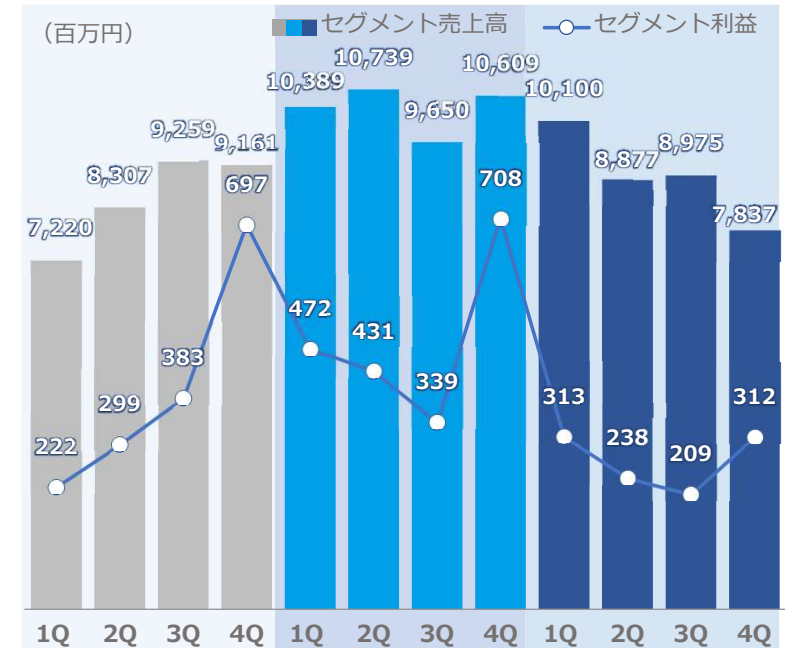
- 前下期から続くメモリーの需給バランス調整等による投資の先送りから減収

### セグメント利益

**1,072**百万円 (前期比▲45.0%)

- 売上高減少に伴う売上総利益の減少
- 開発活動開始に伴う研究開発費の増加
- コロナ会場による営業活動の本格再始動に伴う、交通費・出張費の増加
- 仕入先からの販売報奨金が4Qに寄与

(注) セグメント売上高及びセグメント利益は、連結調整前の数値となっております



(百万円)	2022年3月	2023年3月期	2024年3月期
セグメント売上高	33,950	41,388	35,791
セグメント利益	1,602	1,951	1,072
セグメント利益率	4.7%	4.7%	3.0%

## セグメント別概況 受託製造事業

- 売上高の減少から、セグメント利益は赤字に
- 2Qを底に回復傾向

### セグメント売上高

**5,592**百万円 (前期比▲25.0%)

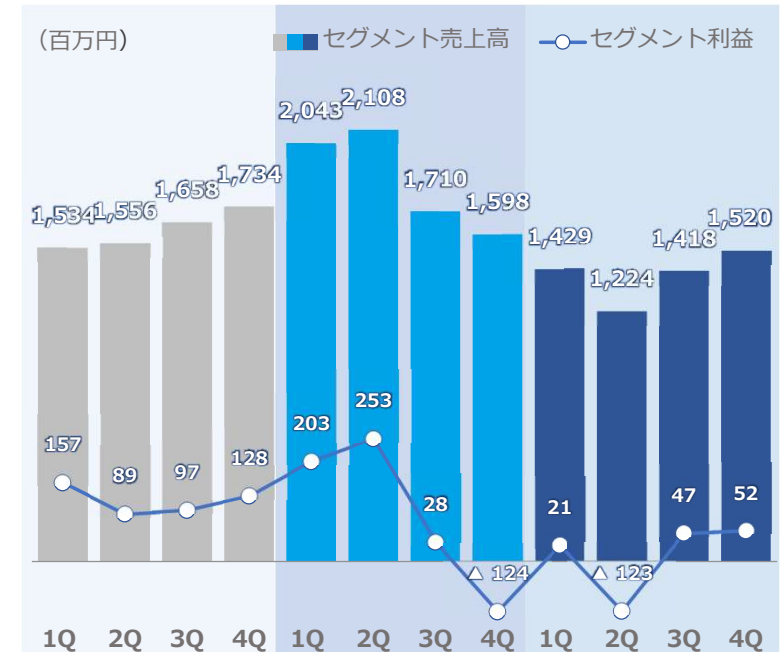
- 前下期から続く半導体メーカーの調整局面による投資先送りを受けて、主要顧客からの受注が減少
- 半導体市場の回復とともに、新規顧客の獲得により、2Qを底に回復

### セグメント利益

**▲2**百万円 (前期比 — )

- 変動費の見直しを図るも、売上減少からセグメント利益は減少
- 売上の上昇とともに、2Qを底に回復

(注) セグメント売上高及びセグメント利益は、連結調整前の数値となっております



(百万円)	2022年3月	2023年3月期	2024年3月期
セグメント売上高	6,483	7,460	5,592
セグメント利益	473	361	▲2
セグメント利益率	7.3%	4.8%	—



# セグメント別概況 受託製造事業（サブ・ポートフォリオ）

## マニファクチャリング・ソリューション

### 顧客からの受託組立

- 半導体主要メーカーの投資先送りを受けて主要顧客の減産により受注減少

## フィールド・ソリューション

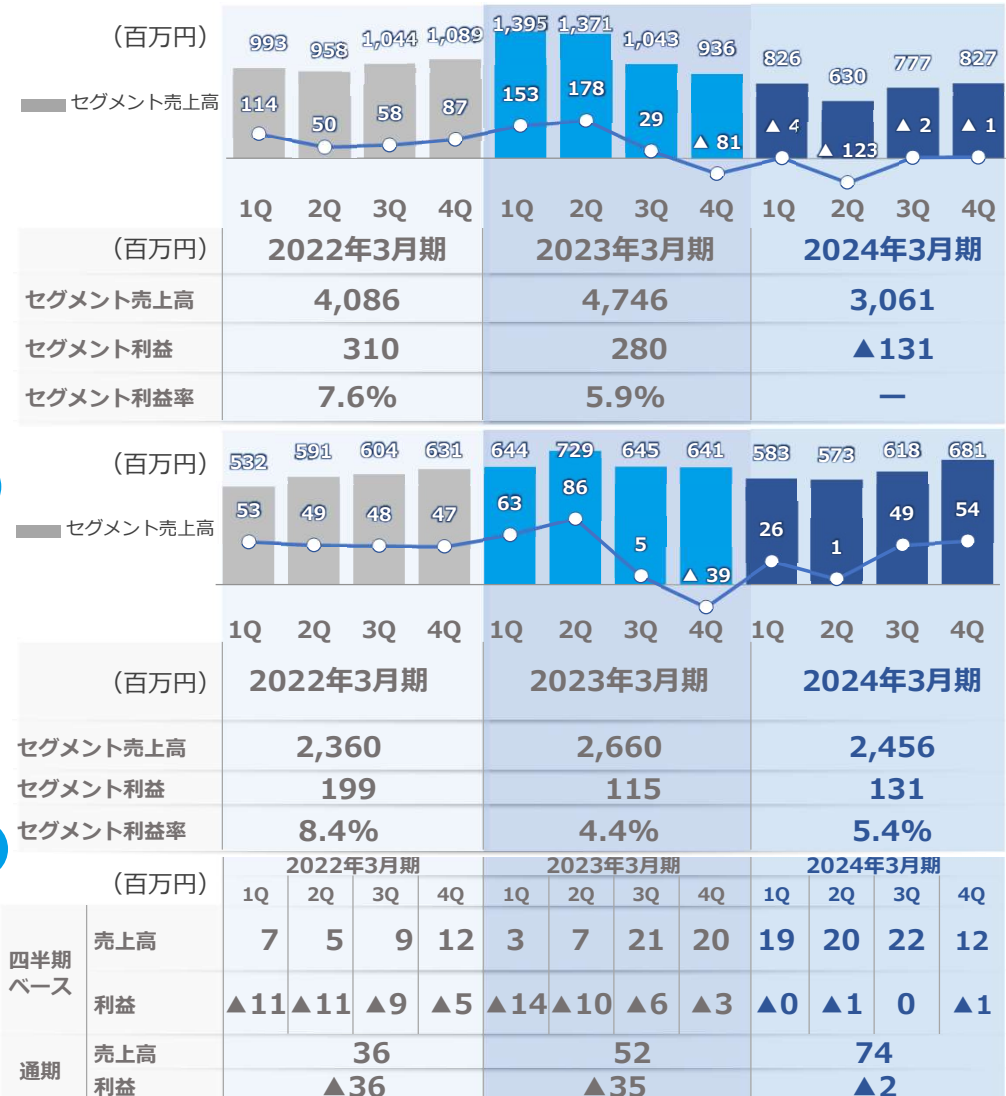
### メンテナンスサポート

- 半導体主要メーカーの投資抑制を受けて、装置立上受注が減少するも、メンテナンスは安定推移
- 国内半導体企業の工場新設に合わせ、フィールド・ソリューション事業拡大のため、エンジニアを増員

## テクニカル・ソリューション

### 自社製品開発・技術開発

- 製品開発に必要な技術の習得への投資を継続。中長期的な成長戦略の中核へ
- 収益は改善

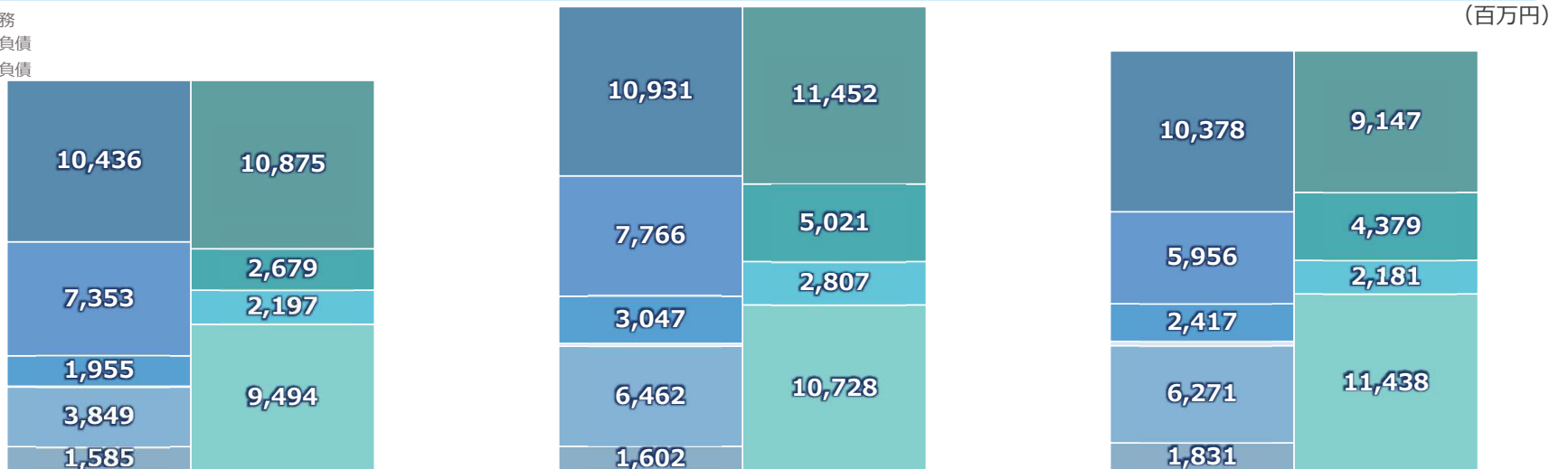


## 連結貸借対照表

- ・保有有価証券の売却・有形固定資産の売却・借入金の圧縮を行い、ライトアセット化を推進
- ・利益の積み上げにより純資産は増加し、総資産の圧縮により自己資本比率は改善

### 連結貸借対照表

■ 現金・預金  
 ■ 売上債権  
 ■ 棚卸資産  
 ■ その他流動資産  
 ■ 有形固定資産  
 ■ その他固定資産  
 ■ 買入債務  
 ■ 有利子負債  
 ■ その他負債  
 ■ 純資産



(百万円)	2022年3月期	2023年3月期	2024年3月期
純資産	9,494	10,728	11,438
自己資本比率	37.6%	35.7%	42.1%

## 連結キャッシュフロー

### ・設備投資の減少により、フリーキャッシュフローは黒字に

#### キャッシュフロー計算書

- 売上減少による税金等調整前当期純利益は減少するも、売上債権・仕入債務のバランスや棚卸資産の減少等により、営業キャッシュフローは11億85百万円に
- 当面の設備増強は前期で完了し、投資キャッシュフローは大幅な支出減少
- コミットメントライン等の極度貸付枠を設定し、新規借入の抑制により、財務キャッシュフローは減少
- 設備投資は、江刺開発センターを中心に2億92百万円実施  
2022年3月期からの大型設備投資は、終了
- 江刺事業所・江刺開発センターの稼働に伴い、償却費は1億22百万円増加し3億87百万円に



(百万円)	2022年3月期	2023年3月期	2024年3月期
設備投資	599	2,876	292
減価償却費	229	265	387

## 配当政策

- 今後の成長のための投資と株主様への還元のバランスを考慮しつつ、企業価値向上を目指す

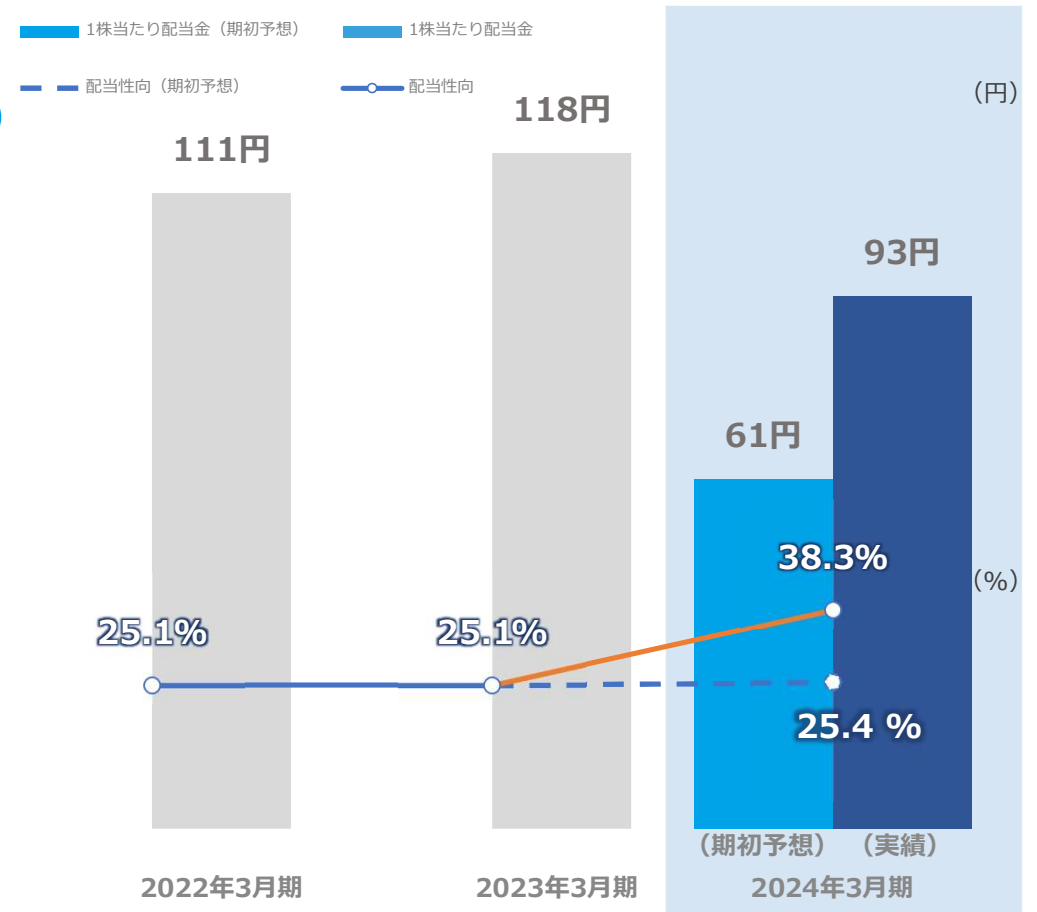
### 基本方針

#### 24年2月に基本方針変更

- 連結配当性向**25%**程度を目標としながら、業績に応じた配当を継続していく



- 連結配当性向**30%**以上かつ  
連結株主資本配当率（DOE）**3%**以上を目標とし、  
業績に応じた配当を継続していく



## サステナビリティ目標の進捗状況

- ・ 24.3期のKPIは82.4%（14/17項目）の達成
- ・ 次期中期経営計画に於いても、人的投資に注力継続

※ ○ = 達成 ▲ = 未達成

マテリアリティ	カテゴリー	サステナビリティ目標	サステナビリティKPI	単位	24.3期			
					目標	実績	目標比	評価
顧客対応力	商社機能	サプライチェーンの最適化	物流コストの削減率（21/3期比）	%	-15.0	-18.9	-3.9	○
		顧客情報の情報セキュリティ	情報セキュリティに関するクレーム件数	件	0	1	1	▲
生産性向上	製造機能	製造部門の効率化	製品品質クレーム数の削減（前年対比）	%	-10.0	-76.7	-66.7	○
		高真空分野の製品量産	量産移行件数（21/3期比）	件	15	0	-15	▲
保守・メンテナンス	保守・メンテナンス機能	中古機部門の技術革新	修理リードタイムの低減（21/3期比）	%	-10.0	0.7	10.7	▲
		リペア部門の一元管理化	保守管理リードタイムの低減（21/3期比）	%	-5.0	-11.7	-6.7	○
製品開発力	R&D機能	高真空分野の製品開発	製品開発数	件	1	1	0	○
経営基盤	経営管理	環境コンプライアンス	環境マネジメント（ISO14001）の維持 審査合格	認証	認証	認証	0	○
		有害物質管理	有害物質含有調査率（回答率）	%	100	100	0	○
		CO2 排出量削減効果	CO2 排出量削減（21/3期比）	%	—	25.8	—	—
		労働安全衛生	重大事故（休業災害）発生件数	件	0	0	0	○
		中核人材における多様性	女性管理者比率（グループ）	%	7.0	7.4	0.4	○
		教育機会の付与	一人あたりの研修時間	時間	20	25	5	○
		コンプライアンス・腐敗防止	重大なコンプライアンス違反（訴訟）件数	件	0	0	0	○
		責任ある鉱物調達	紛争鉱物調査率（回答率）	%	100	100	0	○
		DXの推進・情報管理	デジタル化による業務効率向上 （21/3期比）	%	30	35	5	○
		責任ある情報管理体制	機密情報の流出件数	件	0	0	0	○
		継続的成長を実現する財務基盤の強化	自己資本比率	%	40.9	42.1	1.2	○

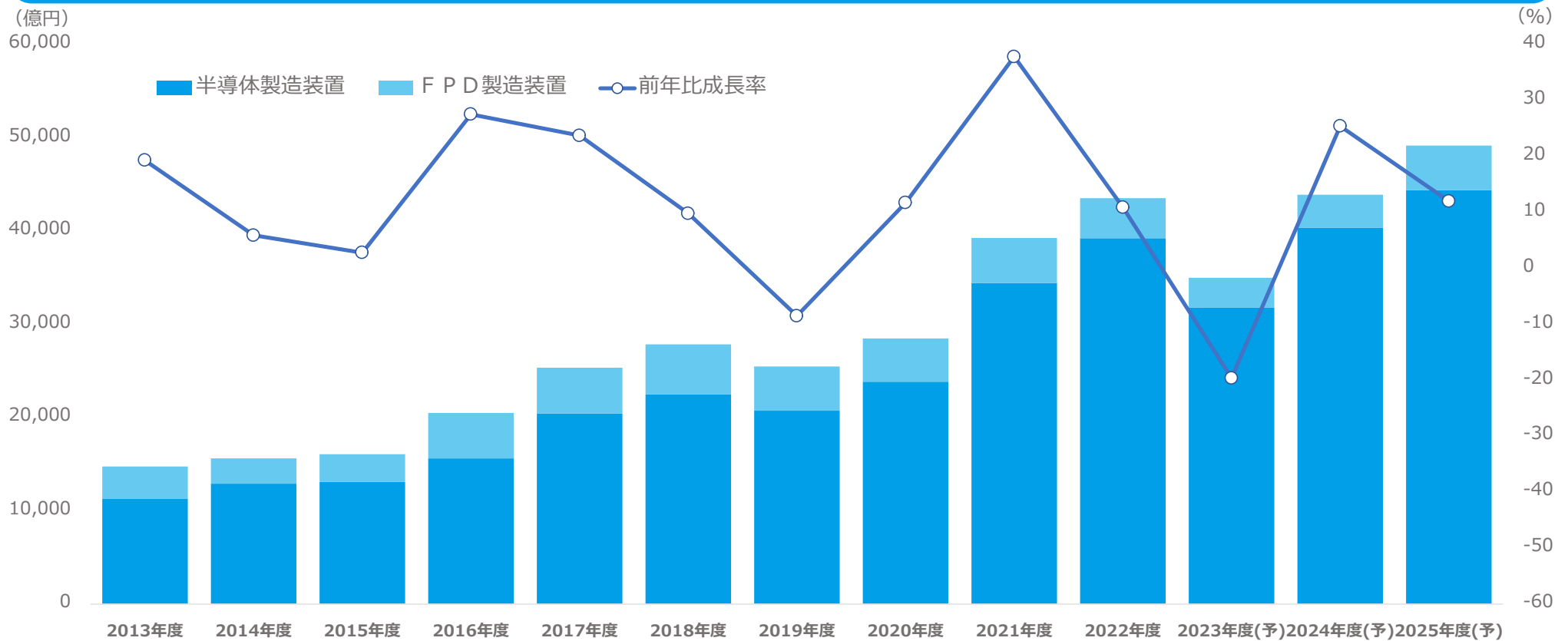


2025年3月期  
**連結業績予想**

## 半導体市場取り巻く環境

- ・ 2024年度は、過去ピークである2022年度の水準へ回復見込む
- ・ 生成AI需要増加等を背景に、中長期的に拡大傾向

### 半導体・FPD装置 日本製装置販売高予想



出所：SEAJ 2024年1月18日発表資料を基に当社にて作成

## 2025年3月期 通期連結業績予想

- ・ 市況回復による増収増益を予想するも、お客様の在庫調整等の影響を踏まえ下期からの回復を見込む

(百万円)	2024年3月期			2025年3月期				
	通期			通期			中間	
	実績	前期比	構成比	通期予想	前期比	構成比	中間予想	前年同期比
売上高	39,013	▲13.8%	100.0	<b>43,800</b>	<b>12.3%</b>	<b>100.0</b>	<b>18,130</b>	<b>▲11.5</b>
営業利益	1,218	▲48.1%	3.1	<b>1,540</b>	<b>26.4%</b>	<b>3.5</b>	<b>390</b>	<b>▲25.2</b>
経常利益	1,189	▲49.1%	3.0	<b>1,520</b>	<b>27.8%</b>	<b>3.5</b>	<b>380</b>	<b>▲25.1</b>
親会社株主に帰属する 当期純利益	848	▲48.2%	2.2	<b>1,030</b>	<b>21.4%</b>	<b>2.4</b>	<b>234</b>	<b>▲27.9</b>
1株当たり配当金	93.0円	—	—	<b>99.0円</b>	—	—	—	—
設備投資額	292	—	—	<b>221</b>	—	—	—	—
減価償却費	287	—	—	<b>303</b>	—	—	—	—



## セグメント別業績予想

- 販売事業は、費用増により増収減益予想
- 受託製造は、大幅な利益改善を見込む

### 販売事業

- 販売事業は、市況の回復に伴い増収を見込む
- お客様の在庫調整等の影響、研究開発・物流投資等による費用増加から減益を予想

### 受託製造事業

- 仕入売上のスキーム変更から売上高は減収
- セグメント利益は実質売上の増加から増益を予想

	2024年3月期		2025年3月期			2024年3月期		2025年3月期	
	実績	通期予想	前期比	実績		通期予想	前期比	実績	通期予想
(百万円)					(百万円)				
セグメント売上高	35,791	40,284	12.6%		セグメント売上高	5,592	5,450	▲2.6%	
セグメント利益	1,072	1,054	▲1.7%		セグメント利益	▲2	337	—	

# 事業ポートフォリオ別業績予想

## ・資本の最適配分を目指し、事業ポートフォリオの見直しを実施

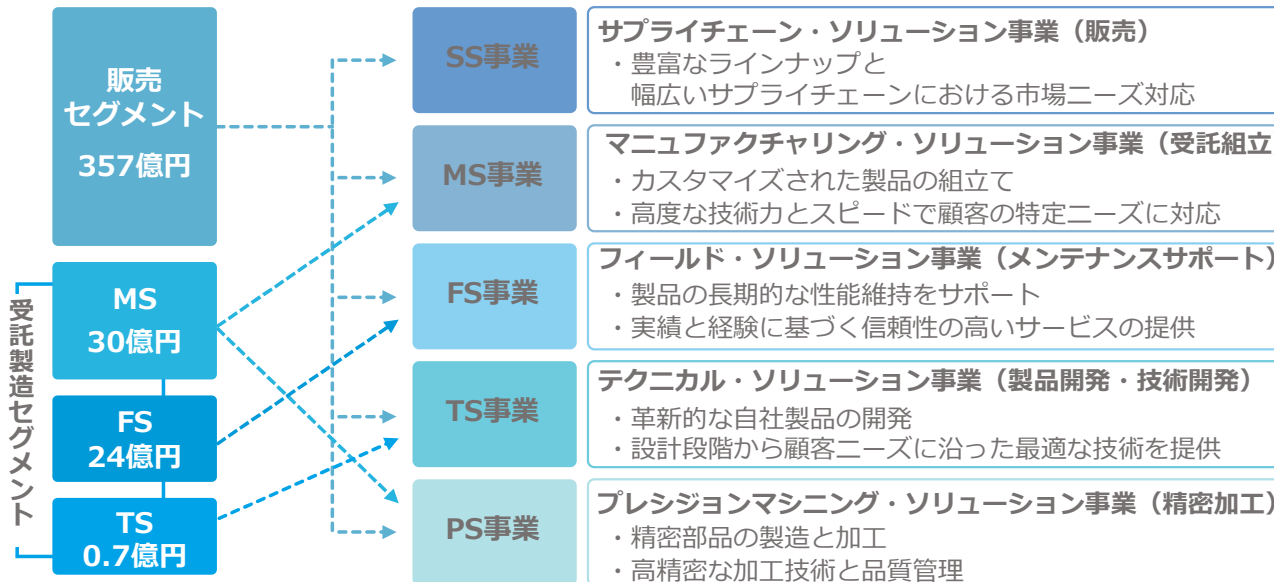
### 事業ポートフォリオへの変更

### 事業ポートフォリオ別売上高予想

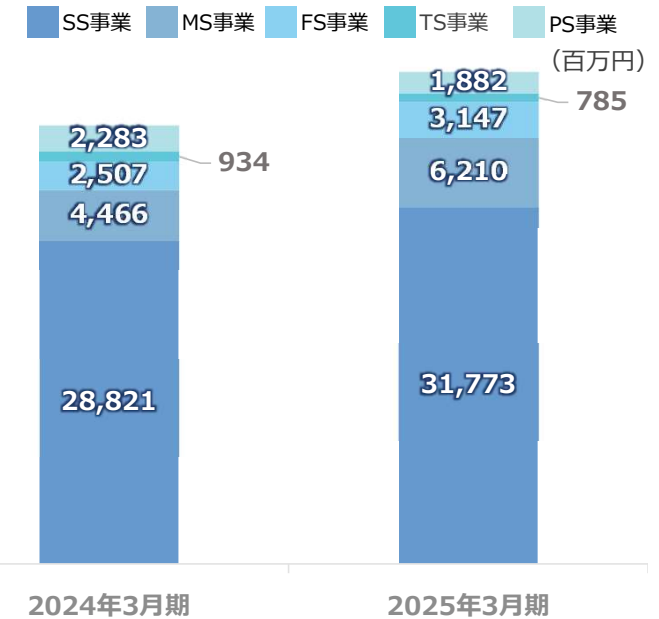
従来サブポートフォリオ  
～24.3期

新事業ポートフォリオ  
25.3期～

新事業ポートフォリオ 事業概要



- 市場の成長に伴いSS事業、MS事業及びFS事業の売上増加を見込む  
今後の成長基盤のためTS事業及びPS事業に注力していく



(注) 売上高は、連結調整前の数値となっております

## サステナビリティ目標

- ・中期経営計画「MIRAI2026」重点戦略に基づき、マテリアリティを抽出「あらたな価値の創造」に向けた「サステナビリティ目標」を設定

ミッション	マテリアリティ	サステナビリティ目標	サステナビリティKPI	実績		KPI目標	単位
				2024年3月期	2025年3月期		
Market creation : 新市場の創造	新市場創造戦略	未開拓市場（新市場・新製品）への進出	開発製品 （自社・共同開発）	1	0		件
Innovation : 技術革新	エンジニア	メンテナンスサポート分野の 技術者増員と、人材育成システムの強化	エンジニアの充足率	97.8	100		%
Resilience : 変化への柔軟な対応	ガバナンス強化	社外取締役の比率、 及び女性取締役の選任	ガバナンス体制の強化	33.3	34		%
	エンゲージメント向上	働きがい、働きやすさの向上と 多様性の確保	女性管理者比率	0	1		人
	環境対応	CO <sub>2</sub> 削減	2030年目標70%減、 2040年NetZero	6.8	8.0		%
Alliance : 変化への柔軟な対応	共同研究開発	他社との協業による 新製品・新技術の研究開発	共同開発による開発件数	6.6	-		%
Integration : サプライチェーンの連携	サプライチェーンと バリューチェーンの統合	サプライチェーン1,500社と、 当社のバリューチェーンの統合により、 市場に新たな価値を提供	営業利益率	1	2		件
資本政策	資本コストを意識した経営	企業価値向上	PBR1倍以上	3.0	3.6		%
				0.996	≥1.0		倍

## 参考資料 会社概要

本社所在地	東京都世田谷区三軒茶屋
設立	1961年6月
事業内容	半導体製造装置の部品の仕入販売、 受託製造が2本柱
従業員数	連結 647名（2024年3月末）
連結子会社	内外エレクトロニクス株式会社 納宜伽義機材（上海）商貿有限公司



本社・東京営業所

納宜伽義機材（上海）  
商貿有限公司

仙台事業所

国内 **34** 拠点

海外 **2** 拠点

※ 内外テック **19** 拠点（新拠点+2）  
 ※ 内外エレクトロニクス **15** 拠点（新拠点+1）  
 ※ 内外機材(上海) **2** 拠点



# 参考資料 当社グループの主力ビジネス

## 半導体製造工程概要



内外テック  
技術提案商社



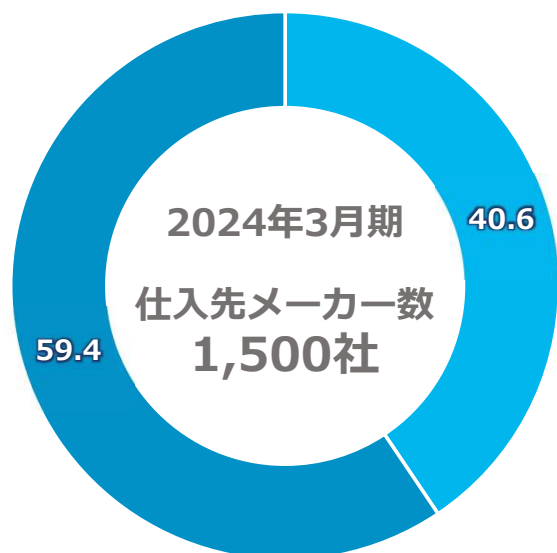
内外エレクトロニクス  
受託製造メーカー



## モノづくりができるメーカー商社

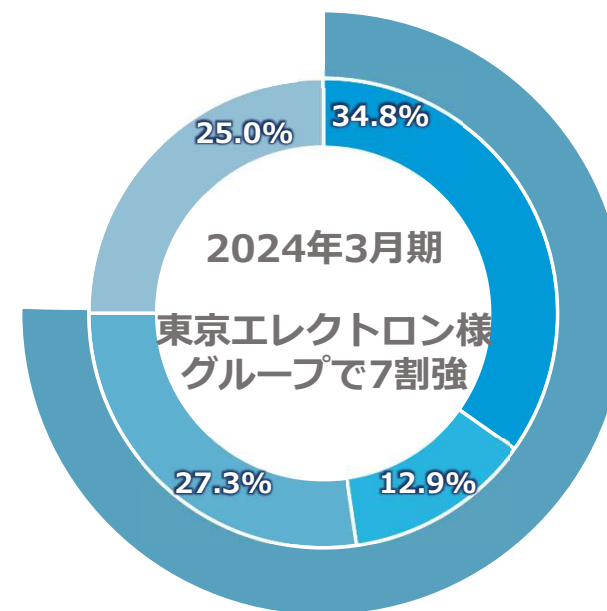
## 参考資料 当社の仕入先・販売先

### 仕入先



■ 空気圧機器メーカー ■ その他メーカー

### 販売先



■ 東京エレクトロンテクノロジーソリューションズ株式会社様  
 ■ 東京エレクトロン宮城株式会社様 ■ 半導体・液晶・電子部品各社  
 ■ 東京エレクトロン九州株式会社様

### 内外テック 仕入先・販売先

仕入先メーカー数	約 1,500件
得意先数	約 900件
年間取扱いアイテム	約 52,000件

主な取扱い商品サービス 空気圧機器、真空関連機器、機工部品、受託製造、メンテナンスサポート、装置改造

# NaigaiTEC Corporation

- ・本資料は投資判断の参考となる情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません
- ・本資料に記述されている当社の業績予想、将来予測などは、当社が作成時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、その実現・達成を保証、約束するものではなく、また、その情報の正確性、完全性を保証、約束するものではありません
- ・銘柄の選択、投資の最終決定は、ご自身の判断でなさるようお願いいたします

## 内外テック株式会社

<https://www.naigaitec.co.jp>

スタンダード：3374